

연수 제안서

연구 분야	스핀트로닉스 소자
연구 과제명	[1] 스핀/양자현상을 이용한 초저전력 및 초고속 스핀 메모리 기술 개발 [2] 스핀-궤도 결합 소재를 이용한 저전력 스핀로직소자
연수 제안 업무	전자빔 리소그래피를 이용한 차세대 스핀소자 공정
<p>(연수 내용)</p> <p>- 연수기간 : 2020.03.01-2021.12.31 (최초 9개월 계약 후, 수행과제 기간까지 총 22개월)</p> <p>- 연수 내용 :</p> <p><input type="checkbox"/> 스핀/양자현상을 이용한 초저전력 및 초고속 스핀 메모리 기술 개발</p> <ul style="list-style-type: none"> - 차세대 스핀 전자소자용 자기터널접합소자 공정 개발 - 비휘발성, 고속정보처리, 고집적화가 가능한 차세대 메모리 소자용 공정 개발 - 높은 터널자기저항비 (TMR)와 낮은 스위칭 전류밀도(Jc)를 구현하기 위한 전자빔 리소그래피 공정 담당 <p><input type="checkbox"/> 스핀-궤도 결합 소재를 이용한 저전력 스핀로직소자</p> <ul style="list-style-type: none"> - 스핀궤도 결합소재에서 발생하는 스핀 전류를 이용한 저전력 스핀 로직 2차원 물질을 이용한 스핀 로직 소자 - 전자빔 리소그래피를 이용한 나노소자 제작 공정 개발 	
<p>소속 부 서 : 스핀융합연구단</p> <p>연수 책임자 : 민병철</p>	